

호서대학교 지역주력산업 연계분야																																								
주력산업	구분	주요내용																																						
반도체 · 디스플레이	세부 산업 분류	<div>□ 반도체</div> <div>① 반도체 장비 : 후공정장비, 측정/검사 장비, 증착장비, 식각장비, 세정 등</div> <div>② 반도체 부품 : 테스터, 설계, 웨이퍼, 제조공정, 센서소자 등</div> <div>③ 반도체 패키징 : 웨이퍼 레벨 패키징, 3D 패키징 등</div> <div>□ 디스플레이</div> <div>① 디스플레이 장비 : 후공정장비, 측정/검사 장비, 증착장비, 식각장비 등</div> <div>② 디스플레이 부품 : 테스터, 설계, 웨이퍼, 제조공정, 센서소자, 세정 등</div> <div>③ 디스플레이 패키징 : 웨이퍼 레벨 패키징, 3D 패키징 등</div> <div>④ 디스플레이 광학 :광학필름, 백라이트유닛, 색재현</div> <div>⑤ 차세대 디스플레이 : 플렉시블 디스플레이, 투명 디스플레이, 홀로그램 디스플레이 등</div> <div><table><tr><th colspan="6">반도체·디스플레이</th></tr><tr><td>시스템 반도체</td><td>반도체 소부장</td><td>반도체 패키징</td><td>디스플레이</td><td>디스플레이 소부장</td><td>디스플레이 공정</td></tr></table></div>				반도체·디스플레이						시스템 반도체	반도체 소부장	반도체 패키징	디스플레이	디스플레이 소부장	디스플레이 공정																							
	반도체·디스플레이																																							
시스템 반도체	반도체 소부장	반도체 패키징	디스플레이	디스플레이 소부장	디스플레이 공정																																			
대학·지역 인프라 현황 및 연계 지원 계획	<div>□ 대학 보유 인프라</div> <div>- 대학내의 반도체·디스플레이 지원을 위한 인적·물적 인프라 보유</div> <div>- 장비, 인증, 컨설팅, 지역산업 연계 지원 등</div> <div><table><tr><th>연번</th><th>협력구분</th><th>지원부서</th><th>지원 역할</th></tr><tr><td>1</td><td>장비</td><td>검인증기술원</td><td>- 반도체디스플레이 장비지원 및 시험/인증, 시제품 제작 지원 등</td></tr><tr><td>2</td><td>학부</td><td>반도체공학과</td><td>- 공동R&D, 반도체 분야 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원</td></tr><tr><td>3</td><td>대학원</td><td>디스플레이공학</td><td>- 공동R&D 및 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원</td></tr><tr><td>4</td><td>전문인력</td><td>반도체특성화대학 사업단</td><td>- 반도체공학과 반도체연계 트랙운영 산업현장 기술전문가 지원</td></tr><tr><td>5</td><td>투자</td><td>투자운영본부 (팁스운영사)</td><td>- 투자기업 발굴, 단계별 투자, TIPS추천 연계</td></tr><tr><td>6</td><td>기술사업화</td><td>기술사업화팀</td><td>- PoC검증, 국가기술거래플랫폼사업 지원</td></tr><tr><td>7</td><td>시제품</td><td>메이커스페이스</td><td>- 시제품 제작 (설계, 디자인, 목업, 제작, 교육 등)</td></tr><tr><td>8</td><td>보육센터</td><td>신기술창업보육센터</td><td>- 보육센터 입주연계 사업화 지원</td></tr></table></div>				연번	협력구분	지원부서	지원 역할	1	장비	검인증기술원	- 반도체디스플레이 장비지원 및 시험/인증, 시제품 제작 지원 등	2	학부	반도체공학과	- 공동R&D, 반도체 분야 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원	3	대학원	디스플레이공학	- 공동R&D 및 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원	4	전문인력	반도체특성화대학 사업단	- 반도체공학과 반도체연계 트랙운영 산업현장 기술전문가 지원	5	투자	투자운영본부 (팁스운영사)	- 투자기업 발굴, 단계별 투자, TIPS추천 연계	6	기술사업화	기술사업화팀	- PoC검증, 국가기술거래플랫폼사업 지원	7	시제품	메이커스페이스	- 시제품 제작 (설계, 디자인, 목업, 제작, 교육 등)	8	보육센터	신기술창업보육센터	- 보육센터 입주연계 사업화 지원
연번	협력구분	지원부서	지원 역할																																					
1	장비	검인증기술원	- 반도체디스플레이 장비지원 및 시험/인증, 시제품 제작 지원 등																																					
2	학부	반도체공학과	- 공동R&D, 반도체 분야 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원																																					
3	대학원	디스플레이공학	- 공동R&D 및 교수진 기술자문 (산업체 전문가) 지원																																					
4	전문인력	반도체특성화대학 사업단	- 반도체공학과 반도체연계 트랙운영 산업현장 기술전문가 지원																																					
5	투자	투자운영본부 (팁스운영사)	- 투자기업 발굴, 단계별 투자, TIPS추천 연계																																					
6	기술사업화	기술사업화팀	- PoC검증, 국가기술거래플랫폼사업 지원																																					
7	시제품	메이커스페이스	- 시제품 제작 (설계, 디자인, 목업, 제작, 교육 등)																																					
8	보육센터	신기술창업보육센터	- 보육센터 입주연계 사업화 지원																																					

미래
모빌리티

세부 산업 분류

□ 미래모빌리티

① 자율주행 : 센서 기술, 라이다(LiDAR), 센서 융합 인식기술
② 인공지능(AI) : 딥러닝 기반의 커넥티드, 클라우드, 모빌리티 플랫폼
③ 배터리 : 배터리 기술, 모터, 부품 등
④ 도심 항공 모빌리티(UAM) : 수직 이착륙(VTOL) , 항공 교통 관리(UTM) 에어 모빌리티 플랫폼 기술
⑤ 마이크로 모빌리티 : 전동 킥보드, 전기자전거 이동기술 자율주행 배송 로봇 기술
⑥ UAM 인프라 : - V2X 통신망, UAM(도심 항공 모빌리티) 인프라 등

미래모빌리티

미래자동차	드론개인이 동수단	자율주행차	전기수소차	첨단 모빌리티
-------	--------------	-------	-------	------------

대학·지역 인프라
현황 및 연계
지원 계획

□ 대학 보유 인프라

- 미래모빌리티 관련 전공 학과, 비교과 프로그램 운영
- 시험·인증 장비(38개) 및 센터 자체 보유
- 전문성을 갖춘 내부 전문가 Pool(67명)을 통해 실현 BM고도화 및 맞춤형 솔루션 제공

연번	협력구분	지원부서	지원 역할
1	장비	검인증기술원	- 장비지원 시험/인증, 시제품 제작 지원 등
2	학부	미래자동차학과 외 9개 학(부)과	- 공동R&D, 교수진 기술자문(산업체 전문가) 지원
3	대학원	자동차ICT공학과 외 35개 학과	- 공동R&D, 교수진 기술자문(산업체 전문가) 지원
4	전문인력	미래형자동차기술 혁신인재양성사업단	- 친환경 모빌리티 연계전공 트랙운영, 산업현장 기술전문가 지원
5	투자	투자운영본부 (팁스운영사)	- 투자기업 발굴, 단계별 투자, TIP추천 연계(5억+2억)
6	기술사업화	기술사업화팀	- 오픈이노베이션 PoC검증, 국가기술개발사업제품사업 지원
7	시제품	메이커스페이스	- 시제품 제작(설계, 디자인, 목업, 제작, 교육 등)
8	보육센터	신기술창업보육센터	- 보육센터 입주연계, 사업화 지원

